

新興ベンダー・ガイド・ツアー 25日

1月25日(金) 15:15 ~

訪問企業

AZURO, INC.

Incentia Design Systems Inc.

GiDEL, Ltd.

MunEDA GmbH

Ponte Solutions Inc.



Azuro, Inc.

- **本社**
 - サンタクララ (Santa Clara, California)、米国
- **会社概要**
 - ナノメータ・チップ設計に必要となる、先進的なクロック設計ツールを提供します
- **製品名**
 - PowerCentric™



Azuro, Inc.

製品のKey Features

CTS およびポストCTS最適化の完全なソリューション

主要なメリット

20% の低電力化

タイミングおよび面積でより優れたクロック設計

マルチ・コーナー、マルチ・モード、マルチ・電圧に対応

- **本社**

- サンタ・クララ (Santa Clara, california)、米国
- シンチュー (Hsinchu)、台湾
- その他: 日本、インド、中国、韓国、イスラエル

- **会社概要**

- タイミング解析、設計、デバッグ及びECOソリューションの最先端技術を提供します

- **カスタマ**

- 世界のトップレベル半導体、システム、ファブレス会社からスタート・アップ会社まで
- 多数のテープアウト実績

Incentia



製品名

- TimeCraft
 - 最高速 STA: サインオフ品質、LOCV、マルチ・スレッド、SI (LOCV: Location, Level-based On Chip Variation)
- TimeCraft-SSTA
 - 統計的 STA
- ECOCraft
 - ポスト・レイアウト、高効率のリーク電力削減とホールドタイム違反の fix (ECO)

主要なメリット

- time-to-market サイクルの大幅短縮
 - 最高速 STA: 2-10 倍高速
 - ECO 収束の短縮
- 高品質のECO 結果

GiDEL, Ltd.



本社

Or Akiva、イスラエル

会社概要

FPGAシステム開発用のプラットフォームやツールを提供するリーディング・カンパニーで、プロジェクトレベルで開発品質向上と期間短縮を実現します

製品名

PROC Wizard

PROC Boards

PROC HILs

GiDEL, Ltd.



製品のKey Features

PROC Wizard

SWとHWの間を自動的に結合

PROC Boards (StratixIII)

35K – 100MG、スケーラブルなFPGA ボード / システム

PROC HILs (Hardware-in-the-Loop simulator)

FPGA ベースHILs (with MATLAB)のワンクリック・ソリューション

主要なメリット

高い経済性:

最新の StratixIII ボードは極めて高い価格性能比

Embedded Systemsのボードも提供

MunEDA

本社

ミュンヘン (Munich)、ドイツ (Headquarter)

サニーベール (Sunnyvale)、米国 (US-Office)

会社概要

アナログ・ミクストシグナル及びデジタル設計のための、歩留まり・パフォーマンス解析と最適化の最先端技術を提供します

Product Names

WiCkeD DFM

WiCkeD DFY

WiCkeD RSM-Modelling

MunEDA

製品のKey Features

WiCkeD DFM

ノミナル回路解析とパフォーマンス最適化

WiCkeD DFY

統計的回路解析と歩留まり最適化

WiCkeD RSM-Modelling

階層的ブロック/システムの歩留まり解析と最適化

主要なメリット

設計時間と労力の大幅な削減

数週間-月かかる設計プロジェクトが週日で終了

設計品質と歩留まりの向上

再設計 / 再試作をなくし歩留まりを最大化

Ponte Solutions Inc.



本社

サンノゼ (San Jose, California)、米国

日本代理店: Cubic Micro (横浜)

会社概要

半導体製造プロセスによるばらつきを解析・予測し、その影響を軽減する
モデル・ベースDFMソフトウェアを提供します

製品

Ponte YA Systems™

Ponte Solutions Inc.



製品のKey Features

- YA System は以下のようなDFMエンジンを含む
- CAA Analysis - 限定的な歩留まりYield感度解析
- CAA + Analysis - システムティック歩留まり感度解析
- VCE Analysis - コンタクト・エッチ補正
- EPC Analysis - ポリ・エッチ補正
- CMP Analysis - 最適化CMPフィル
- パートナーシップによるリソ・ソリューション

主要なメリット

- ワンパッケージになった完全なDFM 解析
- 全ての設計段階に適用化
- 主要な設計環境に統合化されている